

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

## 沪士电子股份有限公司 投资者活动记录表

编号：2026-0303-003

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他：_____
参与单位名称	华福证券、景顺长城、百年资管、兴全基金、个人投资者（2人）  （参会者已签署书面调研承诺函，在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。下文会议纪要中的内容不代表公司对未来的盈利预测和业绩指引，请投资者注意投资风险并谨慎投资。）
时间	2026年3月3日 10:30-11:30
地点	公司会议室
形式	实地调研
公司接待 人员姓名	李明贵、钱元君、马明慧
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>1、公司 2025 年经营情况</p> <p>受益于人工智能和高速网络基础设施的强劲需求，依托平衡的产品布局以及深耕多年的中高阶产品与量产技术，2025 年公司实现营业收入约 189 亿元，同比增长约 42%；实现归属于上市公司股东的净利润约 38.22 亿元，同比增长约 47.74%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约 37.61 亿元，同比增长约 47.69%（<u>2025 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2025 年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。</u>）。</p> <p>以 2025 年半年报的收入结构作为一个参考的基准，公司在数通领域收入结构中最大的依然是高速网络的交换机及其配套路由相关 PCB 产品，其次是 AI 服务器和 HPC 相关 PCB 产品。</p>

## 2、公司经营策略

公司深耕于高速网络交换机及路由器、AI 服务器及 HPC、通用服务器、无线通信网络及智能汽车等高增长、高技术壁垒 PCB 产品领域。在数据通讯领域,公司的产品已经广泛应用于超大规模数据中心、云服务提供商数据中心、企业通讯网络、本地网络及园区网络等场景;在智能汽车领域,公司的产品为汽车的自动驾驶域控制器、智驾系统、智能座舱、三电系统等设备提供核心硬件支持。

公司经营策略是一贯的,差异化经营,将技术能力、制程能力、产能结构动态适配市场中长期的需求结构,坚持面向整体市场的主要头部客户群体开展业务。公司向来注重中长期的可持续利益,而非仅仅局限于眼前的短期利益。公司深知只有着眼长远,保持客户均衡,才能在不断变化的市场环境中稳健发展,实现可持续增长。面向整体市场的主要头部客户群体开展业务,对公司的综合竞争力提出了更高要求,这意味着公司不仅要配备完善的工具包,还要持续打磨综合制程能力与技术能力。

公司专注于高性能与高信赖性 PCB 所需的核心技术,包括高多层、高频高速、高密度互连及高通流等 PCB 关键技术研究。通过对信号完整性、电源完整性与系统集成等基础研发方向的系统布局,公司建立起了系统领先的技术能力。凭借深厚的技术积累,公司能够及时响应技术迭代,应对行业变革,长期保持竞争优势。公司与国内外众多终端客户展开多领域深度合作,适配多技术平台,构建广泛覆盖的技术生态,通过技术创新、均衡的多元化客户结构、供应链韧性及区域布局,在复杂的市场环境中保持韧性和竞争优势,在不确定中锚定确定性。

## 3、资本开支及市场情况

AI 驱动的服务器、数据存储和高速网络基础设施需求增长以及新兴应用领域的拓展为行业带来发展机遇,公司近两年加快资本开支,2025 年前三季度财报现金流量表中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金约 21.04 亿。公司在 2024 年 Q4 规划投资约 43 亿新建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目于 2025 年 6 月下旬开工建设,目前也正有序推进,预期将在 2026 年下半年开始试产并逐步提升产能。该项目的实施能进一步扩大公司的高端产品产能,并更好的配合满足客户对高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对高端印制电路板的中长期需求,增强公司核心竞争力,提高公司经

济效益。除此以外，公司在春节前发布了关于新建高端印制电路板生产项目的公告，项目建设期为2年，总投资约为33亿元人民币；公司全资子公司昆山沪利微电有限公司也正筹划向独立第三方购买土地使用权和建筑物，新建印制电路板生产项目及其配套设施。

2025年明显可以看到，更多的同行也纷纷将资源向该领域倾斜，试图进入该领域并取得一定的市场份额，未来的竞争势必会加剧。公司需要准确把握战略节奏，适度加快投资的步伐，通过深入分析市场趋势和自身发展需求，合理配置资源，将更多的资金投入到具有潜力和创新的领域，不断进行技术升级和创新，开发更高密度的互连技术、更高速的传输性能等，提高产品的竞争力，并快速响应市场需求，从而抢占市场先机，筑牢并拓展“根据地”业务，实现可持续发展。

#### 4、泰国工厂

沪士泰国生产基地于2025年第二季度进入小规模量产阶段，2025年泰国子公司亏损约1.39亿元。沪士泰国在AI服务器和交换机等应用领域，已陆续通过全球头部客户的严格认证，获得正式供应资质，标志着公司全球化交付体系的初步成型。泰国工厂公司正全力提升其生产效率和产品质量，随着客户拓展及产品导入的逐步推进，其产能将逐步有序释放，并进一步验证其中高端产品的生产能力，为产品梯次结构的优化升级奠定基础，为公司全球供应链韧性奠定基础。从2025年第四季度的环比数据来看，其经营形势已迎来拐点，产值规模实现大幅攀升，产品结构进一步优化，生产质量与运营效率亦同步提高。

#### 5、新技术孵化线

正如先前发布的公告，公司计划在常州市金坛区投资设立全资子公司，搭建CoWoP等前沿技术与mSAP等先进工艺的孵化平台，构建“研发-中试-验证-应用”的闭环体系，布局光铜融合等下一代技术方向，系统提升产品的信号传输、电源分配及功能集成能力，待相关技术工艺验证成熟并具备产业化条件后，投建高密度光电集成线路板的规模化生产线。项目涉及CoWoP、mSAP及光铜融合等前沿技术研发，具有研发周期长、技术难度高、工艺复杂等特点。需要提示的是在研发过程中可能面临技术路线偏差、关键工艺无法突破或商业化转化进度不及预期等风险。项目二期的启动取决于一期项目的孵化效果及市场验证，若项目一期未达预期，将直接推迟或终止项目二期投资决策。公司将通过数字化仿真验证、产业链上下游协同研发等手段，深度锁定客户技术演进

	规划，将前沿技术的不确定性转化为可控的工程化实践，降低研发风险，力争实现投资项目的预期效益，为股东创造长远价值。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单	无